

제이앤티씨, 반도체용 유리기판(TGV) 개발 성공

<2024-06-26> 제이앤티씨가 반도체 유리기판 개발에 성공했다.

3D커버글라스 선도기업 제이앤티씨(204270, 대표이사 김윤택, 조남혁)는 30여년동안의 축적된 각 사업장(JNTC의 CNC가공기술, 레이저 가공기술, JNTS의 에칭기술, COMET의 도금기술, JNTE의 설비 기술)의 요소기술을 통합해 반도체용 유리기판(TGV)을 조기 개발할 수 있었다고 26일 공식 발표했다.

실제로 제이앤티씨는 지난 3월 주주총회를 통해 반도체용 유리기판(TGV) 신사업 진출을 공식화했고, 금번 시제품 개발성공을 시작으로 6월말 현재 본격 양산을 위한 Build-up 단계에 진입했다고 밝혔다.

우선적으로 금년 3분기에는 반도체용 유리기판(TGV) 데모라인을 베트남 3공장에 구축하기로 결정하고, 공정별 주요 핵심설비에 대한 발주까지 이미 진행된 상태이며, 이를 위한 1차 투자자금 조달도 우량 기관들의 적극적인 참여하에 성공리에 마무리되었다.

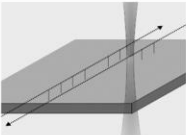
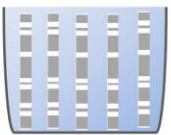
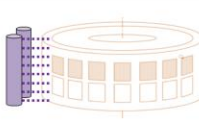
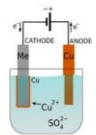
더불어, 제이앤티씨는 "고객사와의 NDA로 인하여 구체적으로 공개하기는 힘들지만 국내외 다수의 글로벌 반도체 패키징 기업과 반도체용 유리기판(TGV)을 2025년 하반기부터 본격 양산 및 판매를 위한 구체적인 사항에 대해 논의를 진행하고 있다"며 "금년 말까지 글로벌 영업망 구축과 함께 현재 확보되어 있는 베트남법인 4공장 부지를 활용해 본격적인 양산준비 체제에 돌입할 것"이라고 전했다.

이에 대해 금년 5월에 신사업 부문의 글로벌 영업망 구축을 위해 새롭게 합류한 제이앤티씨의 조남혁 사장은 "회사의 시제품 개발완료와 함께 신 사업의 본격 양산을 위한 글로벌 영업망 구축에 더욱 속도를 낼 것"이라며 "기존 강화유리 전문기업에서 진정한 글로벌 유리소재기업으로 퀀텀점프할 수 있는 절호의 기회를 맞이한 만큼 투자자와 함께 성장의 결실을 나눌 수 있도록 더욱 정진하겠다"고 자신감을 피력했다.

■ 참고사진 : 제이앤티씨 반도체용 유리기판(TGV) 생산공정

*제이앤티씨가 개발한 반도체용 유리기판(TGV) 생산 공정 사진

제이앤티씨 유리기판 시제품 생산 공정

공정명	홀 가공	홀 형성	씨드 형성	도금	연마
순서					
단면모식					
제품사진					
제품단면				